

經濟部 110 年度  
臺灣資安卓越深耕-半導體及資通訊供應鏈資安關鍵技術發展  
計畫  
合作研究計畫

《供應鏈資安個案研究與政策規範產業應用》

建議書徵求文件

財團法人資訊工業策進會

中華民國 110 年 4 月 13 日

# 110年度合作研究計畫建議書徵求文件

## 一、簡介

為協助我國半導體供應鏈與國際供應鏈資安規範接軌，透過與國際性產業組織合作研究，共同進行半導體企業之國際供應鏈資安合規暨個案研究分析，使廠商在產品設計開發階段即將國際資安規範納入考量，以降低廠商資安風險及合規成本。

## 二、計畫目標

以半導體上、中游產業供應鏈為範圍，協助半導體企業進行接軌國際供應鏈之合規暨個案研究分析，並產出分析報告。

## 三、計畫範圍

1. 半導體企業進行接軌國際供應鏈之合規暨個案研究分析  
以半導體上、中游產業供應鏈為範圍，協助5家半導體企業進行接軌國際供應鏈之合規暨個案研究分析，並產出分析報告。
2. 半導體產業聚落資安合規分析  
應用國際供應鏈資安檢核表，調查我國半導體產業聚落資安合規情形，並分析各聚落資安合規優勢與弱勢。

## 四、預期成果(明確說明合作研究成果之產出)

預期成果包含：

1. 半導體企業進行接軌國際供應鏈之合規暨個案研究分析：  
以半導體上、中游產業供應鏈為範圍，促成5家半導體企業進行接軌國際供應鏈之合規暨個案研究分析，並產出分析報告。
2. 半導體產業聚落資安合規分析  
應用主計畫提供之國際供應鏈資安檢核表，調查至少15家半導體廠商資安合規情形，依據廠商類別分析各聚落資安合規優勢與弱勢，並產出分析報告。

※前述成果如有專利構想或專利申請產出時，需注意專利申請之新穎性(novelty)。因凡經公開發表之研發成果，如擬申請專利，須於公開發表後6個月內完成，前述成果如是以論文方式公開發表，將無法取得大陸與歐盟等國之專利。

## 五、執行方式(包括計畫時程、計畫分工方式)

110年5月31日前：以本會提供之專家問卷完成調查至少15家半導體廠商資安合規情形，依據廠商類別分析各聚落資安合規優勢與弱勢。

110年9月15日前：以本會提供之訪綱完成5家半導體企業接軌國際供應鏈之個案研究，內容包含但不限於該企業之產品、服務、流程與其供應鏈上下游相關資訊。

## 六、計畫期程及預估計畫總經費

計畫執行區間：110年4月1日至110年11月30日

總經費：300,000元

## 七、驗收標準(含教育訓練)

110年5月31日：完成半導體廠商資安合規情形調查執行規畫，包含邀請廠商參與調查的文案內容及預計邀請的廠商名單，並產出1份「半導體廠商資安合規情形調查執行方案」。

110年6月30日：完成調查至少15家半導體廠商資安合規情形，依據廠商類別分析各聚落資安合規優勢與弱勢，並產出1份「半導體廠商資安合規分析報告」。

110年9月15日：完成5家半導體企業接軌國際供應鏈之個案研究，內容包含但不限於該企業之產品、服務、流程與其供應鏈上下游相關資訊，並產出1份「半導體企業接軌國際供應鏈之個案研究分析報告」。

## 八、技術能力需求(請詳述所需要之技術能力或專長)

1. 熟悉半導體產業國際供應鏈資安趨勢。
2. 具備半導體國際供應鏈之合規與個案研究分析相關經驗。